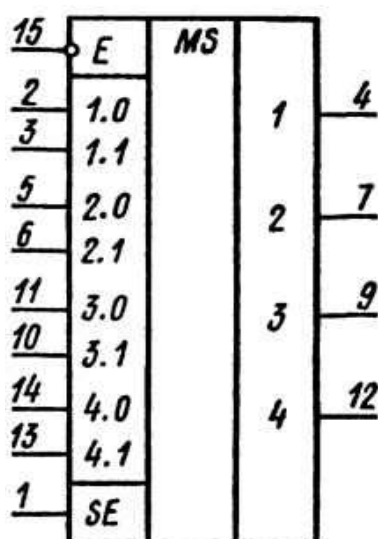


КР1533КП16, КФ1533КП16, ЭКФ1533КП16

Микросхемы представляют собой четырехразрядный селектор 2-1 без инверсии входной информации и предназначены для выбора одного из двух источников данных и передачи на выход. Корпус типа 238.16-1, масса не более 1,2 г и 4307.16-А.

Назначение выводов: 1 - вход выбора SE; 2 - вход информационный D1.0; 3 - вход информационный D1.1; 4 - выход Q1; 5 - вход информационный D2.0; 6 - вход информационный D2.1; 7 - выход Q2; 8 - общий; 9 - выход Q3; 10 - вход информационный D3.1; 11 - вход информационный D3.0; 12 - выход Q4; 13 - вход информационный D4.1; 14 - вход информационный D4.0; 15 - вход разрешения \bar{E} ; 16 - напряжение питания.



Условное графическое обозначение КР1533КП16, КФ1533КП16, ЭКФ1533КП16

Таблица истинности

Входы				Выход
\bar{E}	SE	D0	D1	Q
1	X	X	X	0
0	0	0	X	0
0	0	1	X	1
0	1	X	0	0
0	1	X	1	1

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания	5 В ± 10%
Выходное напряжение низкого уровня:	
- при $I_{\text{вых}}^0 = 4$ мА	≤ 0,4 В
- при $I_{\text{вых}}^0 = 8$ мА	≤ 0,5 В
Выходное напряжение высокого уровня	≥ 2,5 В
Прямое падение напряжения на антизвонном диоде	≤ -1,5 В
Ток потребления при $U_{\text{п}} = 5,5$ В	≤ 11 мА
Входной ток низкого уровня	≤ 0,1 мА
Входной ток высокого уровня	≤ 20 мкА
Входной пробивной ток	≤ 0,1 мА
Выходной ток	-30 ... -112 мА
Время задержки распространения сигнала при включении:	
- от выводов 2, 3, 5, 6, 10, 11, 13, 14 к выводам 4, 7, 9, 12	≤ 12 нс
- от вывода 1 к выводам 4, 7, 9, 12, от вывода 15 к выводам 4, 7, 9, 12	≤ 13 нс
Время задержки распространения сигнала при выключении:	
- от выводов 2, 3, 5, 6, 10, 11, 13, 14 к выводам 4, 7, 9, 12	≤ 14 нс
- от вывода 1 к выводам 4, 7, 9, 12	≤ 24 нс
- от вывода 15 к выводам 4, 7, 9, 12	≤ 20 нс
Емкость входа	≤ 5 пФ

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Напряжение питания	4,5...5,5 В
Входное напряжение низкого уровня	0...0,8 В
Входное напряжение высокого уровня	2...5,5 В
Максимальное напряжение, подаваемое на выход	5,5 В
Температура окружающей среды	-10...+70 °С

Общие рекомендации по применению

Безотказность работы микросхем в аппаратуре достигается: правильным выбором условий эксплуатации и электрических режимов микросхем; соблюдением последовательности монтажа микросхем в аппаратуре, исключающих тепловые, электрические и механические повреждения микросхем.

Лужение производить в следующих режимах: температура расплавленного припоя не более 260 °С; время погружения не более 2 с;

расстояние от корпуса до зеркала припоя (по длине вывода) не менее 1 мм; допустимое количество погружений не более 2; интервал между двумя погружениями не менее 5 мин.

Лужение и пайка должны производиться предпочтительно припоем ПОС61 по ГОСТ 21930-76, флюсом, состоящим из 25% по массе канифоли и 75% по массе изопропилового или этилового спирта.

Установку микросхем на плату производить с зазором, который обеспечивается конструкцией выводов.

Пайку микросхем на печатную плату одножальным паяльником производить по следующему режиму: температура жала паяльника не более 270 °С; время касания каждого вывода не более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между пайками соседних выводов не менее 3 с.

Жало паяльника должно быть заземлено.

Пайку микросхем на печатную плату групповым способом производить по следующему режиму: температура жала группового паяльника не более 265 °С; время воздействия этой температуры (одновременно на все выводы) не более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между двумя повторными пайками выводов не менее 5 мин.

Операцию очистки печатных плат с микросхемами от паяльных флюсов производить тампоном или кистью, смоченными спирто-бензиновой смесью в пропорции 1:1, ацетоном, спиртом или трихлорэтиленом, исключив при этом механическое повреждение выводов.

Сушку печатных плат с микросхемами после очистки производить при температуре не выше 60 °С.

Для влагозащиты плат с микросхемами применять лак УР-231 по ТУ 6-10-863-84 или ЭП-730 по ГОСТ 20924-81. Оптимальная толщина покрытия лаком УР231 должна быть 35...55 мкм, лаком ЭП-730 - 35...100 мкм.

Количество слоев 3.

Рекомендуемая температура сушки (полимеризации) лака 65 ± 5 °С.

Свободные входы необходимо подключать к источнику постоянного напряжения 5 В $\pm 10\%$, к источнику выходного напряжения высокого уровня или заземлять.

Допустимое значение электростатического потенциала 200 В.